

ZO-D200热封盖带

产品介绍

ZO-D200盖带是指在一种应用于电子包装领域的带状产品，与载带配合使用，可在外力或加热的情况下封合在载带的表面，形成闭合的空间，保护载带口袋中电子元器件。

性能参数

项目	测试标准	ZO-D200	单位
颜色	-	透明	-
透光度	-	70~90	%
总厚度	-	55±7	μm
拉伸强度	ASTMD-1000	50	MPa
延伸率	ASTMD-1000	70	%
表面阻抗 (基材面)	-	NA	Ω/□
表面阻抗 (封合面)	-	10 ^{6~11}	Ω/□
撕带剥离力	EIA-481	10~130	g
封合温度	-	160~200	℃
基材	聚酯, 聚脂, 膜		
建议封合条件	PS, PC, A-PET / 2.5kg/cm²		

包装规范

载带宽度	8	12	16	24	32	44	56
盖带宽度(mm)	5.4	9.3	13.3	21.3	25.5	37.5	49.5
卷/箱	16	16	16	16	28	20	16
产品总宽度公差(mm)	±0.10mm						
长度(m)	2500m + 1 / - 0						
轴芯 (mm)	76.5 +/- 0.5						

可按照客户要求，提供其他规格的产品。

储存条件

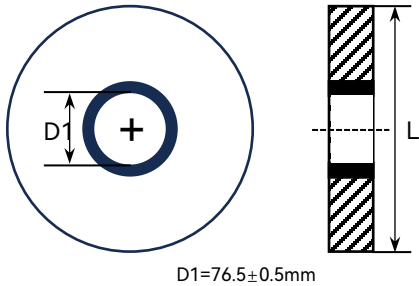
- ✓ 温度：20~30℃
- ✓ 湿度：30-70%的相对湿度

封合温度和剥离力

- ✓ 载带袋口尺寸不同，封合参数将有变化。
- ✓ 客户可以根据自己产品的特性制定标准。



产品包装示意图



保质期

- ✓ 符合储存条件，2年内产品的品质符合要求